

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇电子科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

填补被摊薄即期回报的相关措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，为维护投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关要求，结合公司实际情况，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，拟定了关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺，具体内容如下：

一、公司关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺

本次发行及上市后，公司将采取多方面措施提升公司的盈利能力和水平，尽量减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响，具体措施如下：

1、加强募集资金管理和募投项目推进工作

公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于专门账户，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金投资并定期检查募集资金使用情况；本次发行的募集资金到位后，公司将调配公司内部各项资源，加强募投项目的建设与管理，科学有效地运用募集资金，确保项目顺利实施，争取募投项目早日达产并实现预期收益，以增强公司盈利水平。

2、提高公司盈利能力

公司将加强经营管理和内部控制，增加对主营业务的投入，提升经营效率和盈利能力，努力提高资金使用效率，加强成本和费用控制，提升资金回报，缓解

即期回报被摊薄的风险。

3、强化投资者回报体制

公司已制订了《池州华宇电子科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，对未来分红的具体回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排，建立起健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照相关法律法规、《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）、《池州华宇电子科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，在符合利润分配条件的情况下，重视和积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

如果本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。

二、公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东、实际控制人根据中国证券监督管理委员会及北交所相关规定对公司即期回报摊薄填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送公司利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、本人将督促公司切实履行填补回报措施。

4、本承诺出具日后，如中国证监会、证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺与相关规定不一致的，本人承诺届时将严格按照中国证监会、证券交易所的最新规定与要求执行。

5、如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

三、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证券监督管理委员会及北交所相关规定对公司即期回报

摊薄填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送公司利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 3、对本人职务消费行为进行约束；
- 4、本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 7、本承诺出具日后，如中国证监会、证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺与相关规定不一致的，本人承诺届时将严格按照中国证监会、证券交易所的最新规定与要求执行。
- 8、如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

池州华宇电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月26日